AsiaNet 99859 （0300）

JCETは2022年、技術のアップグレードと変革を加速し、高付加価値アプリケーションで最先端を維持

【上海2023年3月30日PR Newswire＝共同通信JBN】

▽2022年第4四半期の財務状況ハイライト

＊売上高は89億8000万人民元で、前年同期比4.6％の増加。

＊営業利益は16億3000万人民元。純設備投資は12億4000万人民元、フリーキャッシュフローは3億9000万人民元。

＊純利益は7億8000万人民元。

＊1株当たり利益は0.44人民元（2021年第4四半期は0.49人民元）。

▽2022年通期の財務状況ハイライト

＊売上高は337億6000万人民元で、前年比10.7％の増加。JCET史上で最高を記録。

＊営業利益は60億1000万人民元。純設備投資は38億1000万人民元、フリーキャッシュフローは22億人民元。

＊純利益は32億3000万人民元。JCET史上で最高を記録。

＊1株当たり利益は1.82人民元（2021年は1.72人民元）。

集積回路（IC）製造と技術サービスの世界的大手プロバイダーであるJCET Group（SSE: 600584）は30日、2022年12月31日に終了した2022年通期決算を発表しました。決算報告書によると、2022年にJCETは前年比10.7％増の337億6000万人民元の売上高、および前年比9.2%増の32億3000万人民元の親会社株主に帰属する純利益を達成しました。

2022年、JCETは高度なパッケージングとテスト技術および製造における先駆的な取り組みで、成果を上げ続けました。同社は、世界の顧客との綿密なコラボレーションを通じてコア技術力を磨き、差別化された競争優位性を形成しています。同社の高密度多次元異種集積チップレット技術「XDFOI（TM）」は、大量生産（HVM）の段階に入りました。同社は現在、4次元ミリ波レーダー向けのHVM先進パッケージング・ソリューションを複数の顧客に提供しています。当期において、高性能・高密度システムレベルパッケージング技術およびファンアウトウエハーレベルパッケージング技術が貢献した利益および売上高は、前年比で堅調な伸びを示しました。また、コンピューティング・エレクトロニクスやカーエレクトロニクスなどの高付加価値製品の売上シェアも引き続き拡大しました。カーエレクトロニクスの売上高は2022年に前年比85％増、コンピューティング・エレクトロニクスは同46％増となりました。また、5G RF、車載用チップ、高性能コンピューティングチップ、および関連ビジネスなどのテストビジネスが増加し、前年同期比25％の増収となりました。過去3年間において、収益性及び資産構成の継続的な改善、キャッシュフロー能力の向上、資産負債比率の低下により、13四半期連続でプラスのフリーキャッシュフローを達成しました。

JCETは常に顧客を中心に考え、生産とサービスの品質を総合的かつ継続的に向上させ、世界中の顧客や関係者から高い評価を得てきました。同時に、生産能力構造の最適化を進め、顧客の中長期的なニーズに積極的に応えています。Microelectronics Wafer-level Microsystems Integration High-end Manufacturing Project（マイクロエレクトロニクス・ウエハーレベルのマイクロシステム統合ハイエンド製造プロジェクト）の建設は、着実に進展しています。最先端技術分野における製品研究開発力をさらに強化するため、100％子会社であるJCET Management Co., Ltd.の10億人民元の増資を完了させました。韓国工場ではインダストリー4.0のインテリジェントな新工場の建設が完了し、シンガポール工場では一連の自動生産と技術的アップグレードを実現しました。

JCETのLi Zheng最高経営責任者（CEO）は「2022年、当社は最終消費者市場の需要縮小などの不利な外部要因を克服し、カーエレクトロニクス、ハイパフォーマンスコンピューティングなどの分野での新技術開発や、複数の世界的に著名な顧客からの新製品のHVMを完了し、今後の当社の高品質な発展のための確固たる基盤を築くことができました。2022年第4四半期以降、携帯電話などの消費者市場の下落圧力は依然として大きく、世界のIC業界は典型的な下落サイクルにあります。JCETは、柔軟なグローバルレイアウトと、収益と利益率が短期的に圧迫される調整期間を積極的に活用し、後工程のチップ製造プロセスの高性能化、生産ラインの自動化とインテリジェント化を加速し、近い将来の世界市場の回復とアプリケーション需要成長の新ラウンドに十分な準備を提供します」と述べました。

詳細な情報はJCET FY2022 Report(<https://www.jcetglobal.com/uploads/JCET%20Finance%20Report%202022Q4%20V1.pdf> )を参照。

▽JCET Groupについて

JCET Groupは、世界をリードする集積回路製造と技術サービスのプロバイダーで、半導体パッケージ統合設計と特性評価、研究・開発（R&D）、ウエハーテスト、ウエハーバンピング、パッケージ組み立て、最終テストと世界のベンダーへの直送を含むあらゆる種類のターンキーサービスを提供しています。

同社の包括的ポートフォリオは、先端的なウエハーレベルパッケージング、2.5D/3D、システム・イン・パッケージ、信頼性のあるフリップチップとワイヤーボンディング技術に基づき、モバイル、コミュニケーション、コンピューティング、消費者、車載、産業などに向けた幅広い半導体アプリケーションをカバーします。JCET Groupは、中国と韓国に2つの研究・開発センター、中国、韓国、シンガポールに6つの製造拠点を置くほか、世界中に販売センターを持ち、世界の顧客に緊密な技術協力と効率的なサプライチェーン製造を提供しています。

ソース：JCET Group

画像添付リンク：

Link: <http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439431>

Link: <http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439432>

Link: <http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=439433>